

*CIOE中国光博会与SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展将同期举办
展示以下内容

半导体支撑产业

半导体材料

- 硅片
- 封装基板
- 电子特气
- 引线框架
- 特种玻璃
- 键合金丝
- 光刻胶
- 切割材料
- 光掩膜版
- 陶瓷封装材料
- 抛光材料
- 玻璃基板
- 湿电子化学品
- 溅射靶材

晶圆制造设备

- 氧化炉
- 直写机
- 退火设备
- 减薄机
- 涂胶显影设备
- 晶圆切割机
- 光刻机
- 激光切片机
- 刻蚀机
- 清洗设备
- 去胶机
- 抛光设备
- 离子注入机
- 自动晶圆缺陷检测系统
- 薄膜沉积设备
- 高精度光学测量系统

封装设备

- 半导体贴片机
- 焊线机
- 引线键合机
- 成型机
- 倒装键合机
- X-ray 检测设备
- 分选机
- 先进封装工艺（如
- 电子显微镜
- SiP、3D封装）设备
- 光学显微镜
- TGV设备
- 探针台
- 测试机

第三代半导体

- SiC/GaN衬底
- GaN功率器件
- SiC/GaN 外延片
- SiC晶圆制造
- SiC晶体生长炉
- SiC涂层石墨盘
- 外延生长设备
- 切割/研磨/抛光设备
- SiC功率器件

半导体设备核心部件及子系统

核心部件

- 精密运动平台
- 密封圈
- 石英件
- 精密轴承
- 结构件
- 控制器
- 工业传感器
- 射频发生器

- 质量流量控制器
- 镀膜材料
- 气体流量计
- 防静电吸盘
- 真空泵
- 机械臂
- 阀门及阀芯
- 传输系统

光学系统

- 光学镜头
- 光学元件
- 激光光源
- 透镜系统
- 反射镜

晶圆代工/ 制造

- 晶圆制造/代工
- 封装测试厂

扫码完成参观登记
一证参观双展

设计/芯片及应用

- EDA/ IP
- 模拟芯片
- 通信芯片
- 数字芯片
- 存储芯片
- 数字信号处理芯片
- CPU芯片
- 射频芯片
- 传感器芯片
- 驱动芯片

分立器件

- 二极管
- MOSFET
- 高频二极管
- IGBT
- 晶体管

传感器

- MEMS传感器
- 测距传感器
- 视觉感知传感器
- 位移传感器
- 视觉传感器芯片
- 光纤传感器
- 激光雷达
- 红外热电堆阵列传感器
- 图像传感器

光电子器件

- 激光器芯片
- 发光二极管
- 探测器芯片
- 半导体激光器
- 无源光器件芯片
- 光电倍增管
- 光电二极管
- 光模块
- 光电检测器
- 光显示器件
- 光电控制器
- 光放大器

半导体行业